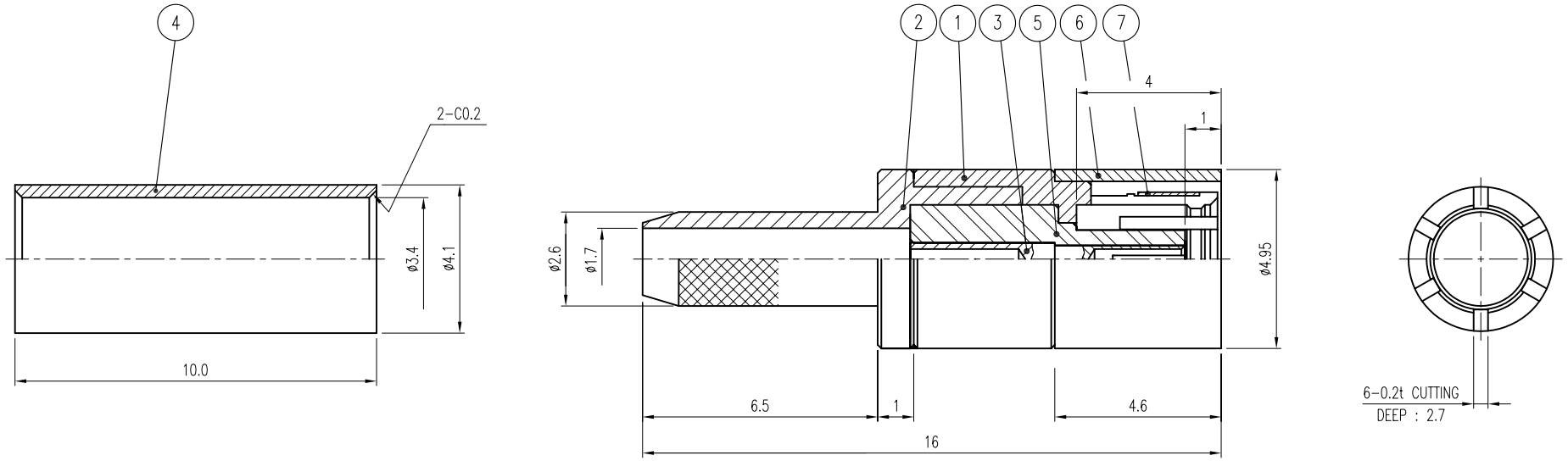
수정내용			
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00037-5/1 (RT002)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00039-5/1 (KT003)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00367-N/1 (HT014)
4	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00041-5/1 (F3009)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate(유광)	DCT00424-5/1 (ET013)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate(유광)	DBD00532-5/1 (DT015B)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate(유광)	DBD00531-5/1 (DT015A)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2005. 8. 10.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 02-32-5475-8015
Fax : 02-32-5475-8017

도명 SMF-JC-316DS VER.0

A3

도번 CN01772-7/1